

半導体パッケージ用基板

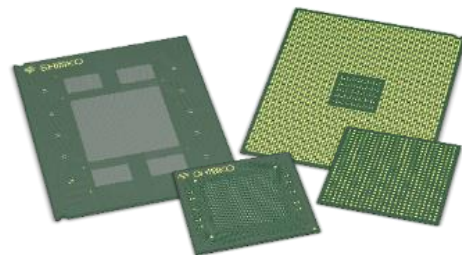
新光電気は、さまざまな機能の半導体パッケージ用基板を提供しています。

■ フリップチップパッケージ用基板 ~ DLL®* ~

セミアディティブプロセス適用による微細な配線パターンと多層構造、スタックビアの採用による優れた電気特性と設計の自由度を持ったフリップチップパッケージ用基板（DLL®）を提供しています。

- ・ フリップ接続用ビルドアップ基板
- ・ 高配線密度 & 高性能基板

* DLL : Direct Laser & Lamination)

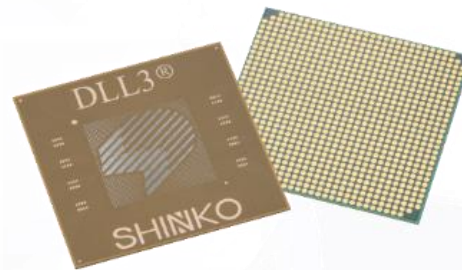


■ フリップチップパッケージ用コアレス基板 ~ DLL3® ~

DLL3®はフリップチップパッケージ用のコアレス基板で、ICチップの高密度・高速化の要求に応えます。

- ・ 新光電気のDLL®技術を活用
- ・ 高配線密度・高性能半導体パッケージ
- ・ 薄型化を実現

DLLおよびDLL3は新光電気工業(株)の登録商標です

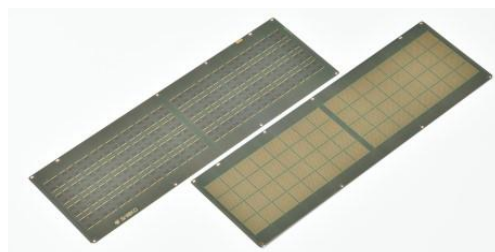


■ プラスチックBGA用基板

ロジック、メモリー、センサーなどのデバイスを実装するBGAパッケージ向けにプリプレグを使用した有機基板を提供しています。

- ・ 車載等、高い信頼性が必要な用途向け、2層または4層の貫通基板
- ・ ビルドアップ基板（IVH）**は電気特性に優れ、高密度多層構造を実現

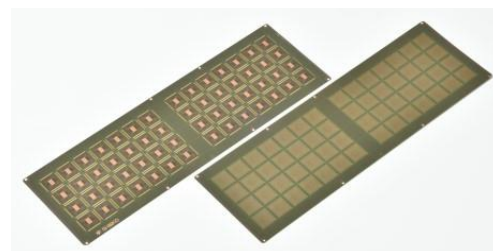
** IVH: Interstitial Via Hole



■ プラスチックBGA用コアレス基板 ~IVH3~

IVH3は、超薄型で特性を向上させたコアレス基板です。

- ・ WB (Wire Bonding) および FC (Flip-Chip) 接続に対応可能
- ・ 3層以上の多層構造
- ・ エッチバックプロセス対応可能



新光電気工業株式会社

〒381-2287 長野県長野市小島田町80

お問い合わせは当社Webサイトからお願いいたします。

<https://www.shinko.co.jp/product/inquiry/form/index.php>



SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.

80 Oshimada-machi, Nagano-shi, Nagano 381-2287 JAPAN

Please contact us via inquiry form on the web.

<https://www.shinko.co.jp/english/product/inquiry/form/index.php>

